

# インドビジネスニュース

## ～インドにおける電子部品製造優遇スキーム（※一部締切間近）～

2025 年 9 月

インドは、2014 年から 10 年以上に渡って政権を運営している現モディ政権の「Make In India」政策の下、国内製造業の振興を目指しています。こうした政策の一環として、2020 年には生産連動型インセンティブ（PLI）と呼ばれる大型の補助金制度を導入して注目されましたが、最近、新たに電子部品の国内製造に特化した補助金制度である「電子部品製造優遇スキーム（ECMS: Electronics Component Manufacturing Scheme）」を発表しました。本レポートでは、この ECMS の概要についてご案内します。

なお、一部分野の募集締め切り期間は、当初の 7 月 31 日から 9 月 30 日に延長されています。締切が近づいていますので、ご関心のある方々は既に申請対応中かも知れませんが、そうでない方々にとっても、インド政府の政策の状況についてご参考になれば幸いです。

### 第 1. 制度導入の経緯

インド政府の政策シンクタンクである NITI Aayog 作成の電子産業に関する国家戦略「Electronics: Powering India's Participation in Global Value Chains」<sup>1</sup>によると、インド国内の電子製品生産額は、2014–15 年度の 300 億米ドルから 2023–24 年度には 1,150 億米ドルへと拡大し、この間の年平均成長率は 17%を超えています。

この間の成長には、インド電子情報技術省（MeitY）による段階的製造プログラム（Phased Manufacturing Programme）、2019 年電子政策（National Policy on Electronics 2019）、生産連動型インセンティブ（PLI）、さらには 2020 年 4 月に開始された大規模な電子製造向け PLI スキーム（LSEM）などの各種政策が寄与してきました。

同文書は、こうした成果を評価しつつ、残されている課題についても論じています。

具体的には、世界の電子機器関連の取引規模が 3 兆ドルに及ぶ中で、インドのシェアは 1%未満に過ぎず、この原因の 1 つとして、国内の部品製造や設計の能力が未熟で、高付加価値部品を輸入に依存していることが指摘されています。

同文書では、2030 年までに国内の電子機器の生産規模を 5000 億ドルに成長させ、世界市場のシェアを 4～5%に引き上げることを目標として掲げており、中国やベトナムの成功要因を分析した上で、目標達成に向けた政策を提言しています。

---

<sup>1</sup> [https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-07/GVC%20Report\\_Updated\\_Final\\_11zon.pdf](https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-07/GVC%20Report_Updated_Final_11zon.pdf)

以上の提言を踏まえ、電子情報技術省は、電子機器の部品に関するエコシステムを国内に構築するために国内外からの投資を促進することを目的として、2025 年 4 月 8 日に ECMS を発表しました<sup>2</sup>。さらに 2025 年 4 月 26 日にはより詳細なガイドラインが発表され、7 月 7 日と同月 30 日に改訂されています。

## 第 2. ECMS の概要

### 1. 対象製品

ESMS の対象製品は、以下の通り、分野 A：サブアセンブリ、分野 B：ベアコンポーネント、分野 C：特定のベアコンポーネント、分野 D：サプライチェーンエコシステム及び資本設備、分野 E：電気通信のサブアセンブリの 5 つの分野に分類されています。

| S.No.    | Target segments                                                                               | Nature of Incentive       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>A</b> | <b>Sub-assemblies</b>                                                                         |                           |
| 1        | Display module sub-assembly                                                                   | Turnover linked incentive |
| 2        | Camera module sub-assembly                                                                    |                           |
| <b>B</b> | <b>Bare components</b>                                                                        |                           |
| 3        | Non-Surface mount devices (non-SMD) passive components for electronic applications            | Turnover linked incentive |
| 4        | Electro-mechanicals for electronic applications                                               |                           |
| 5        | Multi-layer Printed Circuit Board (PCB)                                                       |                           |
| 6        | Li-ion Cells for digital applications (excluding storage and mobility)                        |                           |
| 7        | Enclosures for Mobile, IT Hardware products and related devices                               |                           |
| <b>C</b> | <b>Selected bare components</b>                                                               |                           |
| 8        | High-density interconnect (HDI)/ Modified semi-additive process (MSAP)/ Flexible PCB          | Hybrid incentive          |
| 9        | SMD passive components                                                                        |                           |
| <b>D</b> | <b>Supply chain ecosystem and capital equipment</b>                                           |                           |
| 10       | Parts/components used in manufacturing of sub-assembly (A) and bare components (B) & (C)      | Capex incentive           |
| 11       | Capital goods used in electronics manufacturing including their sub-assemblies and components |                           |
| <b>E</b> | <b>Sub- assembly - Telecom</b>                                                                |                           |
| 12       | Optical transceiver SFP (Small form-factor) pluggable                                         | Turnover linked incentive |

### 2. 対象となる投資の種類

次に、対象となる投資として、以下が定められています。

- 新規（グリーンフィールド）と既存（ブラウンフィールド）投資の双方が対象。
- 外資系企業であっても、FDI ポリシー（2020 年版）を遵守すれば申請可能。
- 製品ごとに個別申請が必要。同一製品に対する複数申請は無効。

<sup>2</sup><https://ecms.meity.gov.in/documents/ECMS%20Notification%20notified%20on%2008.04.2025.pdf>

### 3. 認定基準

認定基準は、申請者の全世界における電子システム設計製造収益（ESDM revenue）の額で定められていますが、これを満たさない場合には、製造収益（manufacturing revenue）の額と技術力、財務能力といった要素に基づいて判断されます。具体的な基準額は、分野毎に定められています。

#### （１） 分野 A～C の場合

申請者は、2023-24年度において、全世界ベースで以下のESDM収益基準か製造収益基準を満たす必要がありますが、後者のみを満たす場合は、さらに技術力について証明する必要があります。なお、合併事業の場合には、収益は持株比率に応じた加重平均で計算すると定められています。

| Target Segment                                                            | ESDM revenue (Rs) | Manufacturing revenue (Rs) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. Display module sub-assembly                                            | 250 crore         | 750 crore                  |
| 2. Camera module sub-assembly                                             | 250 crore         | 750 crore                  |
| 3. Non-SMD passive components                                             | 50 crore          | 150 crore                  |
| 4. Electro-mechanicals for electronic applications                        | 50 crore          | 150 crore                  |
| 5. Multi-layer PCB                                                        | 50 crore          | 150 crore                  |
| 6. Li-ion Cells for digital applications (excluding storage and mobility) | 250 crore         | 750 crore                  |
| 7. Enclosures for mobile, IT hardware products and related devices        | 250 crore         | 750 crore                  |
| 8. HDI/MSAP/Flexible PCB                                                  | 500 crore         | 1500 crore                 |
| 9. SMD passive components                                                 | 250 crore         | 750 crore                  |

#### （２） 分野 D の場合

この分野の申請は随時判断されると定められており、投資額と純資産額の関係性に応じて、以下の財務資料の提出が求められています。

- 純資産が投資額の 50%以上の場合：2024 年 3 月 31 日以前の純資産証明書を提出。
- 純資産が提案投資額の 50%未満の場合：取締役会決議と資金源の開示が必要。

#### （３） 分野 E の場合

この分野では、ESDM 収益基準は 5 億ルピー、製造収益は 15 億ルピーとされています。

### 4. インセンティブの内容

ECMS の下、認定されたプロジェクトに対して、以下の 3 種類のいずれかのインセンティブが支給されます。

- ① 売上連動型インセンティブ：基準年に対する売上増加に対して、一定率で算出された金額を支給。
- ② 設備投資型インセンティブ：対象製品の製造にかかる資本支出の額に対して、一定率で算出された金額を支給。
- ③ ハイブリッド型インセンティブ：①と②を組み合わせで支給。

これらのインセンティブの支給期間は最大 6 年間（設備投資型は最大 5 年間）で、申請は四半期ごとに可能とされています。なお、支給総額は累積投資額の最大 50%までで、先着順で処理されます。

## 5. 申請方法と申請期間

申請者は、インド国内で設立された法人又は有限責任事業組合である必要があります。申請は専用ポータル（<http://www.ecms.meity.gov.in>）を通じて、オンラインで行います。

申請期間は以下の通りです。

- 分野 A、B、C、E：2025 年 5 月 1 日～9 月 30 日
- 分野 D：2025 年 5 月 1 日～2027 年 4 月 30 日

また、申請には、事業計画書、投資・売上・雇用の見通し、現地化戦略、設備リストなどの提出が必要です。

## 6. 生産連動型インセンティブ（PLI スキーム）との違い

PLI スキームと ECMS は、互いにインドの電子産業成長戦略において補完的な役割を果たしますが、目的は異なります。PLI が完成品の輸出競争力強化を図るのに対し、ECMS は部品供給体制の強化と輸入依存の低減を目指しています。

| スキーム | 対象                   | インセンティブ     | 目的                    |
|------|----------------------|-------------|-----------------------|
| PLI  | 完成品（携帯電話、IT ハードウェア等） | 売上増加に対する支給  | 輸出競争力の強化              |
| ECMS | 部品                   | 売上連動型＋設備投資型 | 部品供給体制の強化、<br>輸入依存の低減 |

## 7. 最後に

現在のモディ政権は、2014 年の政権発足当初から「Make In India」の旗印の下、国内の製造業の発展を重要な政策目標としてきましたが、近年は、注力分野に対する国内外からの投資を呼び込むために補助金も積極的に活用するスタイルが目立ってきました。

今回紹介したのは中央政府によるインセンティブですが、州政府による独自のインセンティブが追加的に適用される場合もあります。

また、今後も、様々なインセンティブが展開される可能性があり、インド政府による補助金を含めた政策の動向が注目されます。

◆◇ 発行情報 ◇◆

■発行元

松田綜合法律事務所（2025 年度インド愛知デスク運営業務受託者）

担当：弁護士 久保達弘・長泉地薫大

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大成 大手町ビル10階

TEL: 03-3272-0101（代表） FAX: 03-3272-0102

事務所HP：[www.jmatsuda-law.com](http://www.jmatsuda-law.com)

過去のニュース記事はこちら：<https://jmatsuda-law.com/india-aichi-desk/>